

SC-SMT 3.81/10/270G 3.2SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ



270° 取り出し方向の SC-SMT ピンヘッダー：270° の角度は、差し込み接続方向およびソルダーピンの間に該当します。プラグ接続方向は、基板に対して平行です。ただし、ソケットブロックは基板に対して反転平行のプラグ接続角度を有します。

- 部品および装置設計時の自由度が高くなります。
- 複数の プリント基板による単体ハウジング内の並列配置での高い部品密度
- 電線取出し方向を任意に選択できるため、用途に応じたハウジング設計が可能です。
- サイドクロース (G)、およびねじフランジ (F) のバージョンが使用可能。
- ピンの長さは 1.5 mm または 3.2 mm です

ワイドミュラー 3.81mm ピッチ (0.15 インチ) プラグインコネクタは、標準的な同タイプのコネクタとレイアウトの互換性があります。マーキングスペースがあり、識別表示が可能です。

一般注文データ

| | |
|------------|--|
| バージョン | プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, 閉側, THT/THRはんだ接続, 3.81 mm, 極数: 10, 270°, ソルダーピン長 (l): 3.2 mm, 錫メッキ, 黒色, 箱 |
| 注文番号 | 1036570000 |
| 種別 | SC-SMT 3.81/10/270G 3.2SN BK BX |
| GTIN (EAN) | 4032248765164 |
| 数量 | 50 Stück |
| 製品データ | IEC: 320 V / 17.5 A UL: 300 V / 11 A |
| パッケージ | 箱 |

SC-SMT 3.81/10/270G 3.2SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

| | | | |
|------------|------------|-----------|------------|
| 深さ | 9.2 mm | 奥行き (インチ) | 0.362 inch |
| 高さ | 10.3 mm | 高さ (インチ) | 0.406 inch |
| 下位バージョンの高さ | 7.1 mm | 幅 | 39.49 mm |
| 幅 (インチ) | 1.555 inch | 正味重量 | 2.468 g |

システム仕様

| | | | |
|-----------------------------|---------------------------------|---------------------------|------------------|
| 製品ファミリー | OMNIMATE信号 - BC/SC 3.81シリーズ | 接続方式 | 基板接続 |
| PCB の取り付け | THT/THRはんだ接続 | ピッチ (mm) (P) | 3.81 mm |
| ピッチ (インチ) (P) | 0.15 " | 外向きエルボ | 270° |
| 極数 | 10 | 極当たりソルダーピン数 | 1 |
| ソルダーピン長 (l) | 3.2 mm | ソルダーピン長 公差 | +0,02 / -0,02 mm |
| はんだピン寸法 | d = 1.0 mm, 八角形 | はんだピンの寸法= d公差 | 0 / -0,03 mm |
| ソルダーアイレット穴直径 (D) | 1.3 mm | ソルダーアイレット穴直径公差 (D) | +0.1 mm |
| はんだパッドの外径 | 2.1 mm | テンプレート開口径 | 1.9 mm |
| L1 (mm) | 34.29 mm | L1 (インチ) | 1.35 " |
| 行数 | 1 | ピンモデルシリーズ数量 | 1 |
| DIN VDE 57 106に適合したタッチセーフ保護 | フィンガーセーフプラグ抜き/バックオブハンドセーフのプラグ差込 | DIN VDE 0470に適合したタッチセーフ保護 | IP20接続/IP10接続解除 |
| 体積抵抗 | ≤5 mΩ | コーディング可能 | はい |

材料データ

| | | | |
|--------------|----------|----------------------|--------|
| 絶縁材 | LCP GF | 色 | 黒色 |
| カラーチャート (類似) | RAL 9011 | 絶縁材グループ | IIIa |
| 比較追跡指数 (CTI) | ≥ 175 | Moisture Level (MSL) | 1 |
| UL 94 可燃性等級 | V-0 | 接点材質 | 銅合金 |
| 接触表面 | 錫メッキ | 保管温度、最小 | -40 °C |
| 保管温度、最大 | 70 °C | 動作温度、最小 | -50 °C |
| 動作温度、最大 | 120 °C | 温度範囲、設置、最小 | -25 °C |
| 温度範囲、設置、最大 | 120 °C | | |

IEC規格に準拠した公称データ

| | | | |
|-----------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------|
| 標準に準拠して検査済 | IEC 60664-1, IEC 61984 | 定格電流、最小極数 (Tu=20°C) | 17.5 A |
| 定格電流、最大極数 (Tu=20°C) | 17 A | 定格電流、最小極数 (Tu=40°C) | 17.5 A |
| 定格電流、最大極数 (Tu=40°C) | 15.1 A | サージ電圧等級の定格電圧/汚染度 II/2 | 320 V |
| サージ電圧等級の定格電圧/汚染度 III/2 | 160 V | サージ電圧等級の定格電圧/汚染度 III/3 | 160 V |
| サージ電圧等級の定格インパルス電圧/汚染度 II/2 | 2.5 kV | サージ電圧等級の定格インパルス電圧/汚染度 III/2 | 2.5 kV |
| サージ電圧等級の定格インパルス電圧/汚染度 III/3 | 2.5 kV | 短時間耐電流抵抗 | 3 x 1sで76 A |

CSAに準拠した公称データ

| | | | |
|----------------------|-------|----------------------|------|
| 定格電圧 (グループ B/CSA 使用) | 300 V | 定格電流 (グループ B/CSA 使用) | 11 A |
|----------------------|-------|----------------------|------|

SC-SMT 3.81/10/270G 3.2SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

UL 1059に準拠した公称データ

設定 (cURus)



証明書番号 (cURus)

E60693

定格電圧 (グループ B / UL 1059 使用) 300 V

定格電圧 (グループ D / UL 1059 使用) 300 V

定格電流 (グループ B / UL 1059 使用) 11 A

定格電流 (グループ D / UL 1059 使用) 11 A

承認値への参照

仕様は最大値です - 詳細については承認証明書を参照してください。

梱包

パッケージ

箱

VPE 長

170 mm

VPE幅

40 mm

VPEの高さ

70 mm

分類

ETIM 6.0

EC002637

ETIM 7.0

EC002637

ETIM 8.0

EC002637

ETIM 9.0

EC002637

ECLASS 9.0

27-44-04-02

ECLASS 9.1

27-44-04-02

ECLASS 10.0

27-44-04-02

ECLASS 11.0

27-46-02-01

ECLASS 12.0

27-46-02-01

ECLASS 13.0

27-46-02-01

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC

/

RoHS 対応状況

準拠 (免除なし)

重要なメモ

IPC準拠

適合性：製品の開発、製造、および出荷は、国際的に認められた基準と基準に従って行なわれ、データシートに記載された保証された特性を遵守します。IPC-A-610「クラス2」に準拠して装飾的な特性を満たします。製品に関するさらなる請求は、要求に応じて評価できます。

注意事項

- 要求に応じて追加のバリエーション
- 定格断面積および最小値に関連する定格電流極数。
- 公称データは、コンポーネント自体のみを指します。他のコンポーネントとのクリアランスおよび沿面距離は、関連する適用規格に従って設計する必要があります。
- 図面上のP = ピッチ
- OMNIMATE コネクタは IEC 61984 に準拠した切断容量 (COC) のないコネクタです。指定された使用中、活性化中や負荷がかかっているときにコネクタを抜き差しすることはできません
- 平均温度 50 °C、最大湿度 70%、36ヶ月の長期保存が可能

SC-SMT 3.81/10/270G 3.2SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

認可



| | |
|-----------------------|-----------|
| ROHS | 適合 |
| UL File Number Search | UL ウェブサイト |
| 証明書番号 (cULus) | E60693 |

ダウンロード

| | |
|-------------------|---|
| 承認/証明書/適合証明書 | Declaration of the Manufacturer |
| エンジニアリングデータ | CAD data – STEP |
| カタログ | Catalogues in PDF-format |
| ブローシャー | FL DRIVES EN MB SMT EN FL DRIVES DE MB DEVICE MANUF. EN FL BUILDING SAFETY EN FL APPL LED LIGHTING EN FL INDUSTR.CONTROLS EN FL MACHINE SAFETY EN FL HEATING ELECTR EN FL APPL INVERTER EN FL_BASE_STATION_EN FL ELEVATOR EN FL POWER SUPPLY EN FL 72H SAMPLE SER EN PO OMNIMATE EN PO OMNIMATE EN |
| ホワイトペーパーの表面取り付け技術 | Download Whitepaper |

SC-SMT 3.81/10/270G 3.2SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

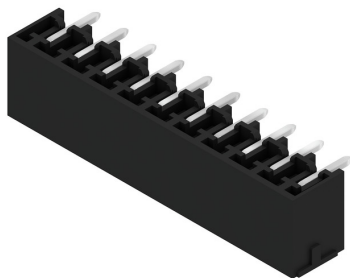
D-32758 Detmold

Germany

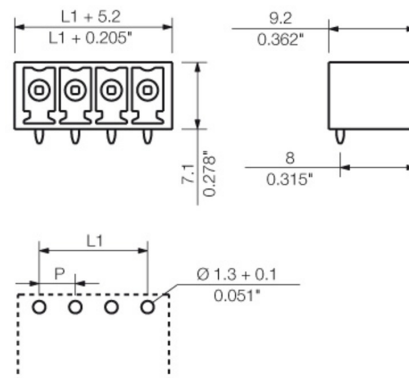
www.weidmueller.com

図面

製品イメージ



寸法図



SC-SMT 3.81/10/270G 3.2SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

コーディングパーツ



続すべきものだけを接続：適切な場所に適切な接続を提供します。
コーディングエレメントとロックングデバイスは、製造工程と運用中の接続エレメントを明確に割り当てます。コーディングエレメントとロックングデバイスは、ケーブルの組立前または組立中に取付できます。ワイドミュラーでは、オンライン上でコンフィギュレータを使用し、事前に仕様を設定することができます。プリント基板への誤った組立てや、接続部品の誤挿入を防止します。
利点は、製造時のトラブルシューティングを無くし、ユーザーによる操作ミスを防ぐことができます。

一般注文データ

| 種別 | SC-SMT 3.81 KO BK BX | バージョン | 製品データ | パッケージ |
|------------|----------------------------|-------------------------------------|-------|-------|
| 注文番号 | 2460700000 | プリント基板用プラグインコネクタ, アクセサリ, コーディングパーツ, | | 箱 |
| GTIN (EAN) | 4050118480023 | 黒色 | | |
| 数量 | 100 Stück | | | |
| 種別 | SC-SMT 3.81 KO WT BX | バージョン | 製品データ | パッケージ |
| 注文番号 | 2467670000 | プリント基板用プラグインコネクタ, アクセサリ, コーディングパーツ, | | 箱 |
| GTIN (EAN) | 4050118494693 | 白色 | | |
| 数量 | 100 Stück | | | |

Recommended wave soldering profiles

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Single Wave:



Double Wave:



Wave soldering profiles

Wired connection elements should be processed in accordance with the DIN EN 61760-1 standard. We have included two recommendations for practical wave soldering profiles, with which Weidmüller PCB terminals and connectors are qualified.

When choosing a suitable profile for your application, the following factors also need to be considered:

- PCB thickness
- Proportion of Cu in the layers
- Single/double-sided assembly
- Product range
- Heating and cooling rates

The single and double wave profiles each indicate the recommended operating range, including the maximum soldering temperature of 260°C. In practice, the maximum soldering temperature is quite often well below the above maximum profile.

We reserve the right to make technical changes.

Recommended reflow soldering profile

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Reflow soldering profile

The perfect soldering profile for SMT Surface Mount Technology is one the most exiting question in SMT production. But there are more than one correct answer: The diagram of temperature-on-time is related to processing features of solder paste and to maximum load of components.

We have to consider the following parameters:

- Time for pre heating
- Maximum temperature
- Time above melting point
- Time for cooling
- Maximum heating rate
- Maximum cooling rate

We recommend a typical solder profile with associated process limits. With preheating components and board are prepared smoothly for the solder phase. Heating rate is typically $\leq +3\text{K/s}$. In parallel the solder paste is 'activated'. The time above melting point of 217°C the paste gets liquid and components and boards begin to connect. The maximum temperature of 245°C to 254°C should stay between 10 and 40 seconds. In the cooling phase at $\geq -6\text{K/s}$ solder is cured. Board and components cool down while avoiding cold cracks.